

証券コード：6314

# 平成27年3月期 決算説明資料



**株式会社 石井工作研究所**  
**ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.**

<http://www.i-kkco.jp>

# 決算説明資料の構成

1. 平成27年3月期決算概要
2. 平成28年3月期通期業績予想
3. 会社概要
4. 技術・新製品開発



# 1. 平成27年3月期 決算概要

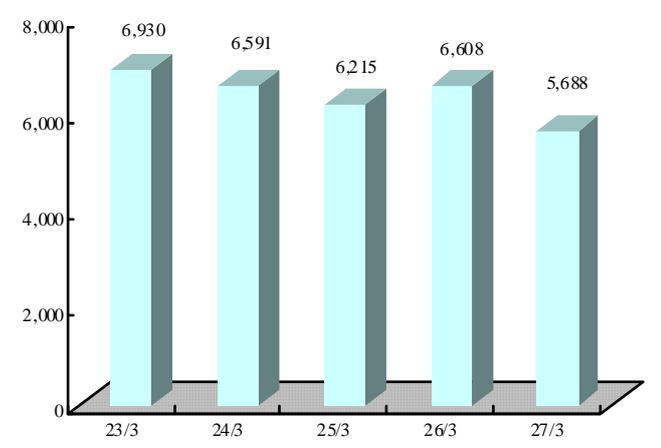
## 1. 最近5年間の業績の推移

回 次	第 33 期	第 34 期	第 35 期	第 36 期	第 37 期
決 算 年 月	平成 23 年 3 月	平成 24 年 3 月	平成 25 年 3 月	平成 26 年 3 月	平成 27 年 3 月
売 上 高 (千円)	2,513,026	2,352,886	2,350,192	3,089,711	3,234,302
売上総利益又は 売上総損失(△) (千円)	495,993	183,162	235,243	447,186	△11,526
販売管理費及び 一般管理費 (千円)	691,946	611,717	557,524	490,153	455,461
営業損失(△) (千円)	△195,952	△428,555	△322,280	△42,966	△466,988
経常損失(△) (千円)	△113,685	△389,023	△318,487	△13,076	△437,032
当期純利益又は 当期純損失(△) (千円)	△118,726	△363,460	△394,935	100,166	△528,467
資 本 金 (千円)	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300	1,186,300
発行済株式総数 (株)	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,800,000
純 資 産 (千円)	5,862,667	5,409,524	5,023,868	5,124,546	4,535,648
総 資 産 (千円)	6,930,718	6,591,792	6,215,002	6,608,803	5,688,672
1株当たり純資産額 (円)	754.22	695.94	646.35	659.34	583.58
1株当たり配当額 (円)	10.00	5.00	5.00	6.00	2.50
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円)	△15.27	△46.76	△50.81	12.89	△67.99
自 己 資 本 比 率 (%)	84.6	82.1	80.8	77.5	79.7
自 己 資 本 利 益 率 (%)	—	—	—	2.00	—
株 価 収 益 率 (倍)	—	—	—	16.21	—
配 当 性 向 (%)	—	—	—	46.6	—
営業活動によるキャッシュフロー (千円)	158,308	△483,960	△290,403	△230,564	△537,352
投資活動によるキャッシュフロー (千円)	66,133	150	△35,538	169,210	13,266
財務活動によるキャッシュフロー (千円)	△194	△78,374	△54,096	△54,202	288,446
現金及び現金同等物残高 (千円)	1,996,092	1,433,909	1,054,821	938,061	693,637
従 業 員 数 (名)	267	261	251	245	242

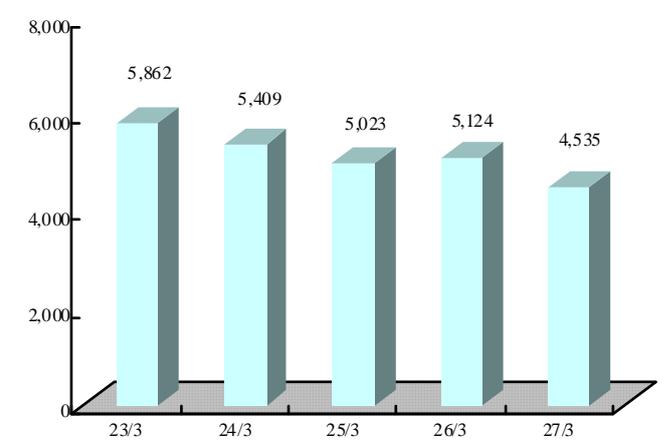


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

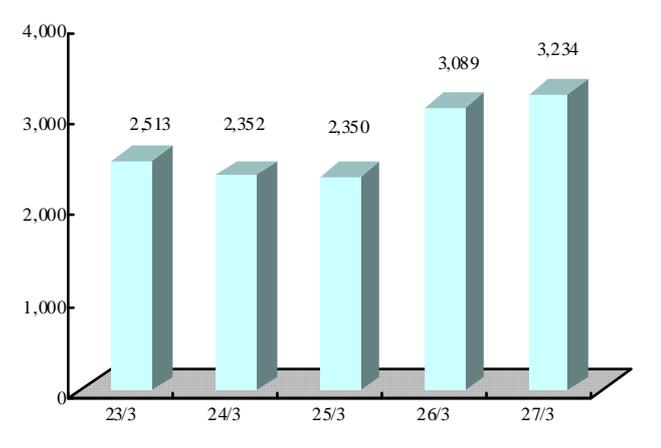


純資産 Net Assets (百万円/¥Millions)

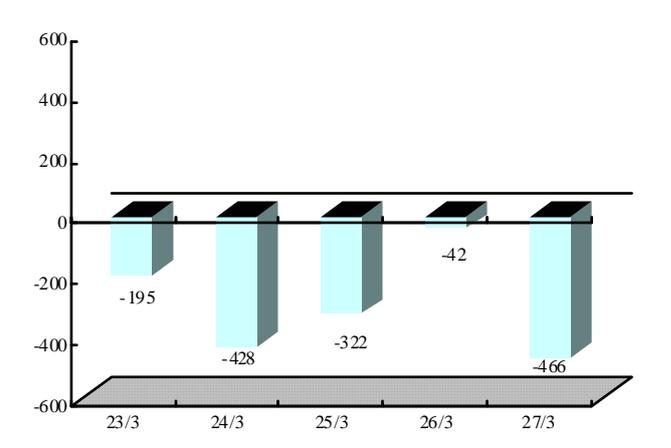


業績推移 Operating results

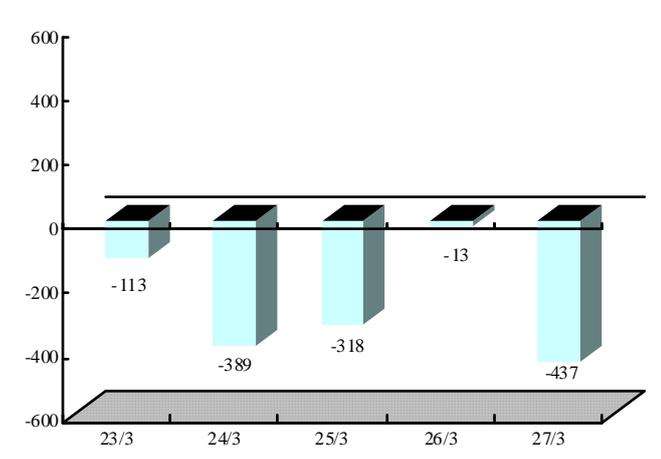
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



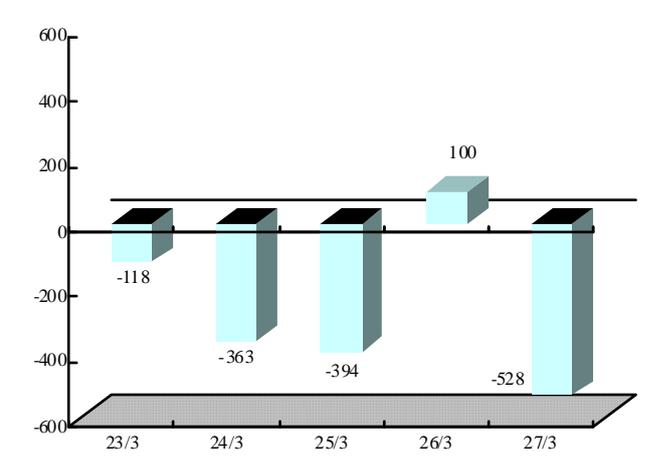
営業損失 Operating loss (百万円/¥Millions)



経常損失 Ordinary loss (百万円/¥Millions)

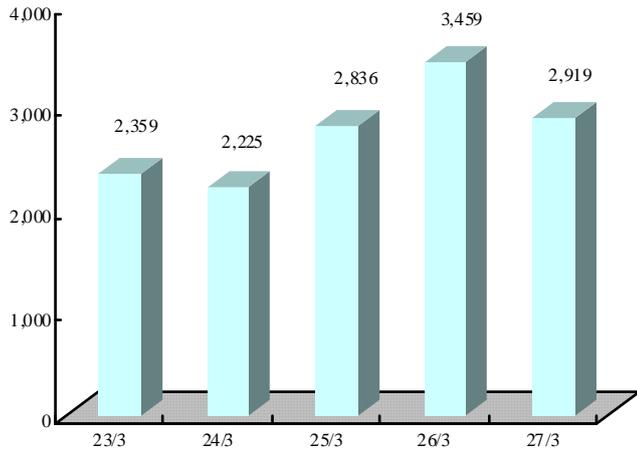


当期純利益又は当期純損失 Net income or loss (百万円/¥Millions)

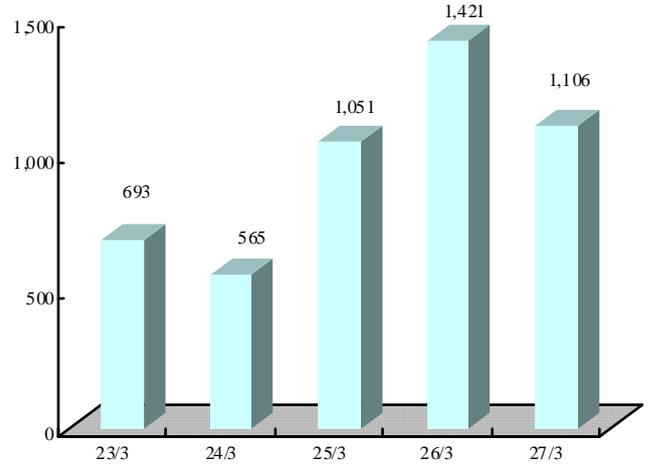




受注高 Order received (百万円/¥Millions)

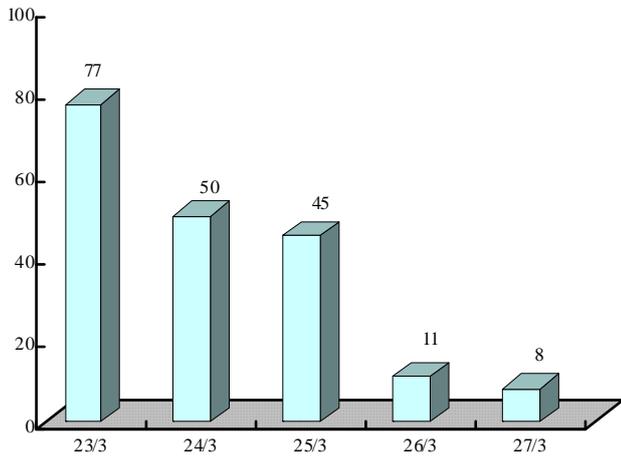


受注残高 Order backlog (百万円/¥Millions)

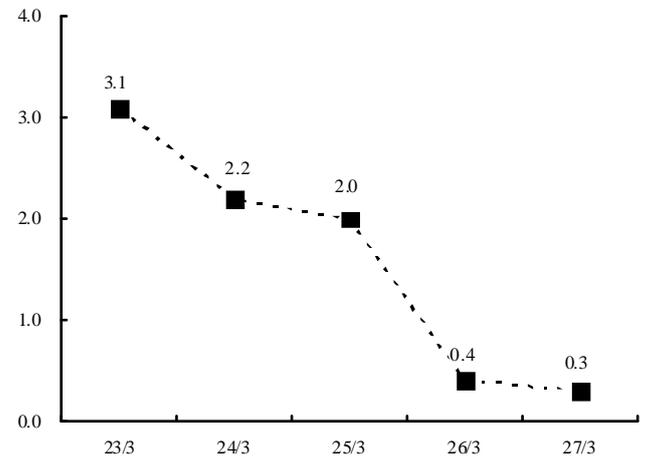


設備投資額・研究開発費等指標 Capital expenditures/Research and development expenses Data

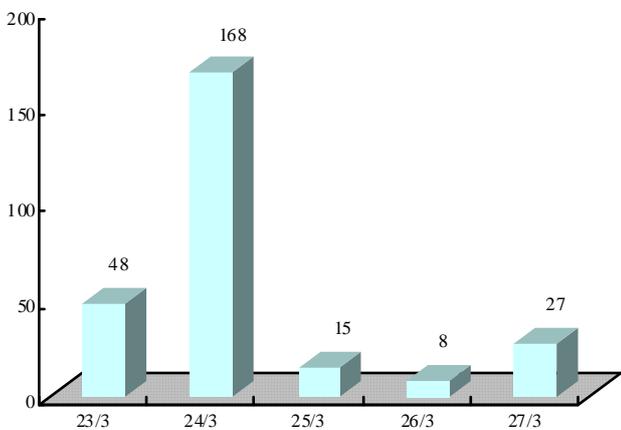
研究開発費 Research and development expenses (百万円/¥Millions)



研究開発費の対売上比率 Ratio of sales to research and development expenses (%)

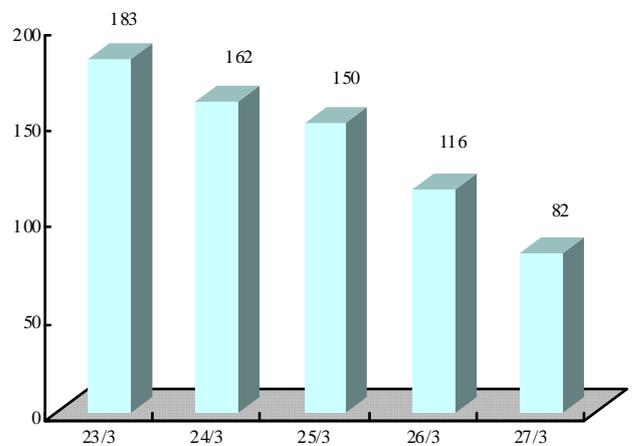


設備投資額 Capital expenditures (百万円/¥Millions)



注 リース取得価額相当額を含む

減価償却費 Depreciation (百万円/¥Millions)

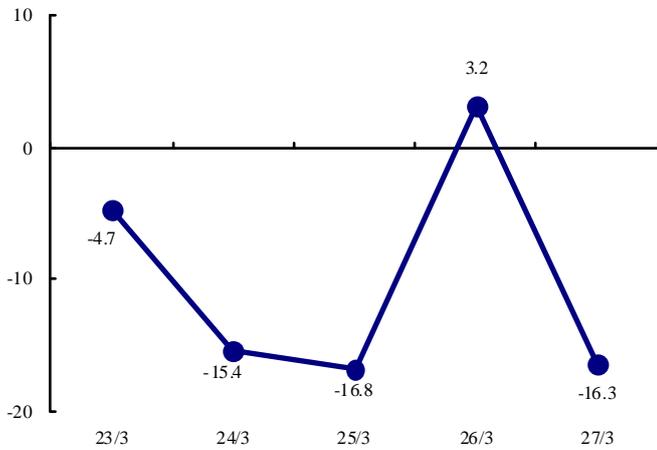


注 支払リース料における減価償却費相当額を含む

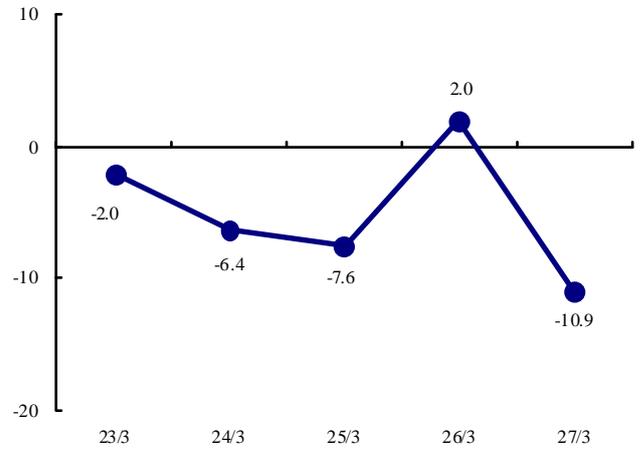


收益性指標 Profitability

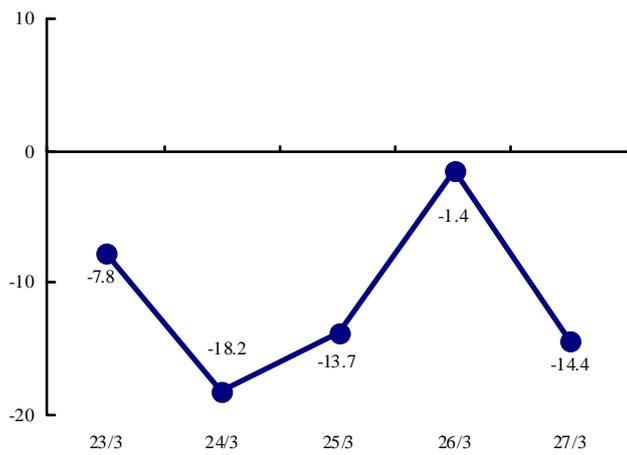
売上高純利益率 Net income to net sales (%)



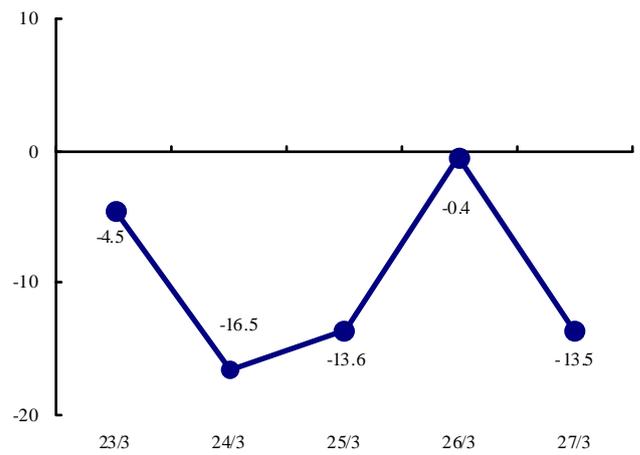
自己資本利益率 Return on equity (%)



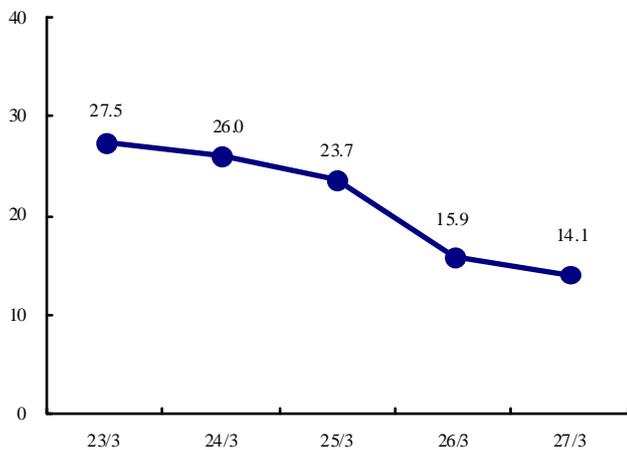
売上高営業利益率 Operating income to net sales (%)



売上高経常利益率 Ordinary income to net sales (%)



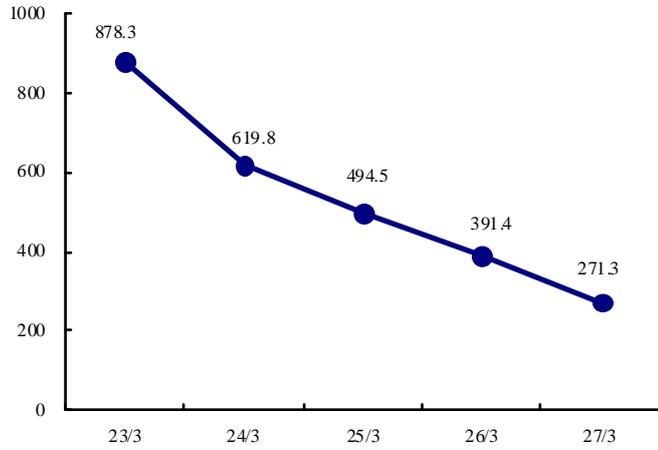
販管費の対売上比率 Ratio of sale to selling, general and administrative expenses (%)



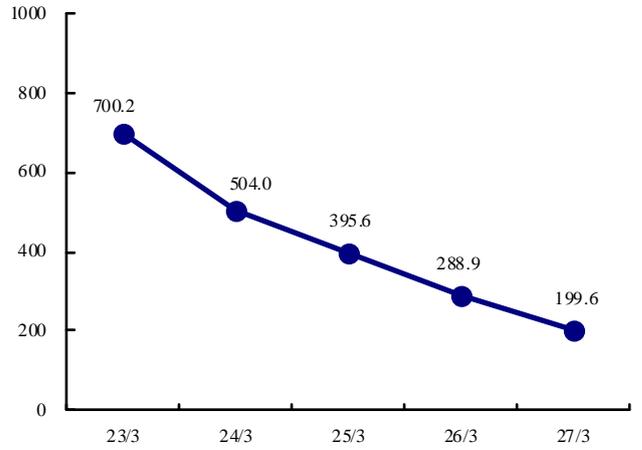


安定性指標 Financial stability

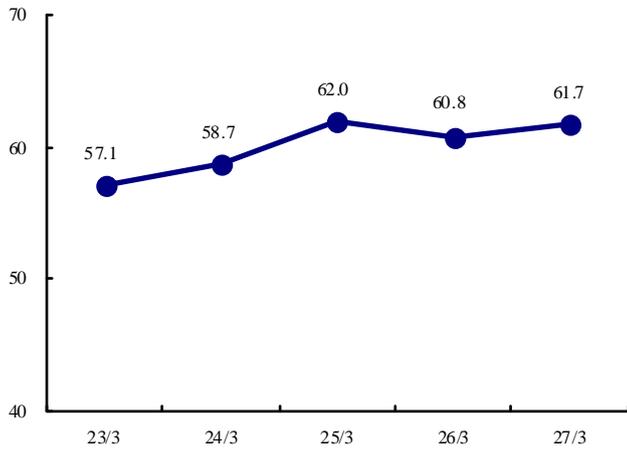
流動比率 Current ratio (%)



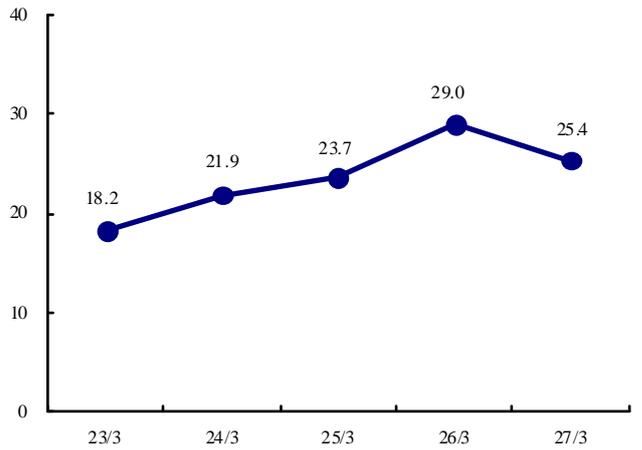
当座比率 Quick ratio (%)



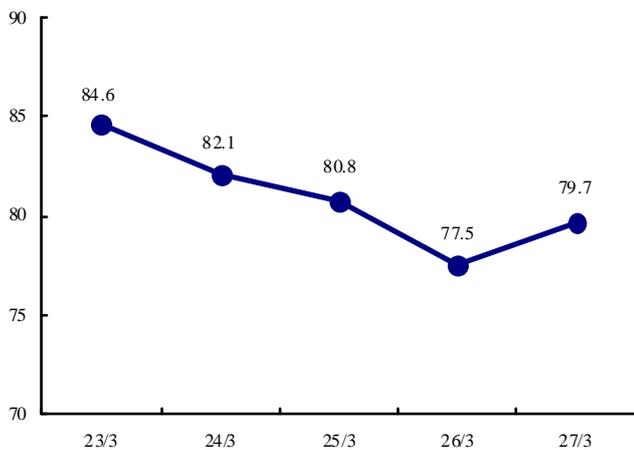
固定比率 Fixed assets ratio (%)



負債比率 Liabilities to shareholders' equity ratio (%)



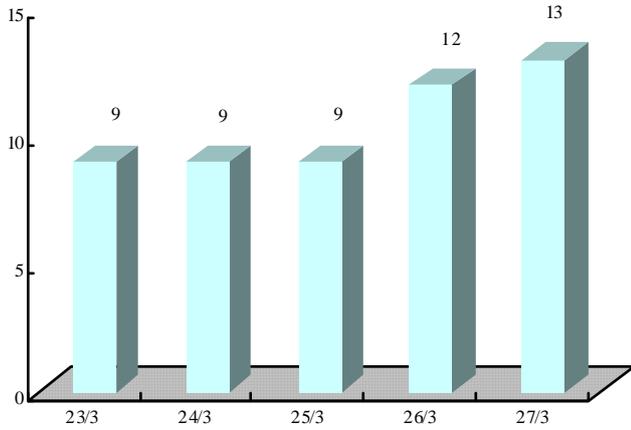
自己資本比率 Shareholders' equity to total assets (%)



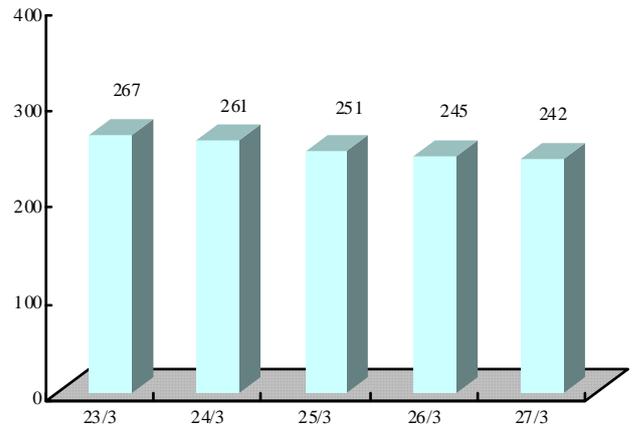


従業員 1 人当たり指標 Per employee Data

従業員 1 人当たり売上高 Net sales per employee (百万円/¥Millions)

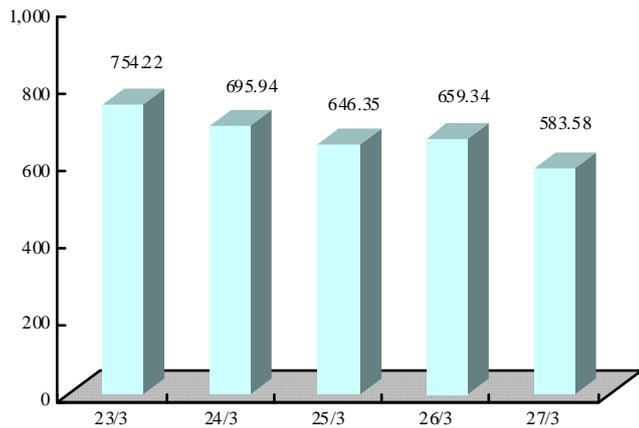


期末従業員数 Number of employees at fiscal year-end (人/persons)

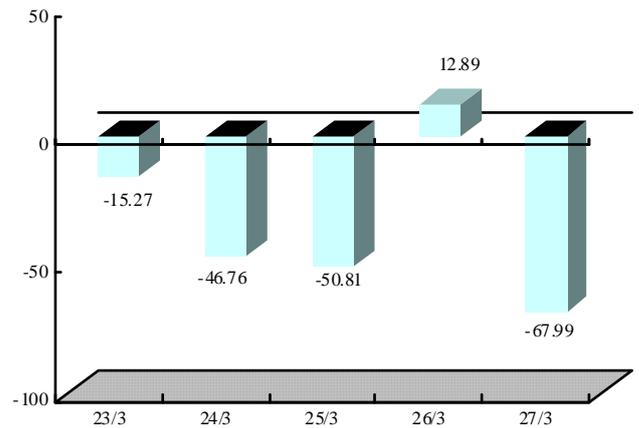


1 株当たり指標 Per share Data

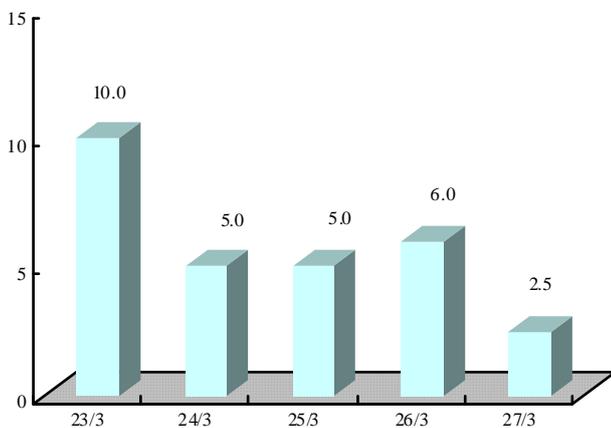
1 株当たり純資産 Book-value per share (円/¥)



1 株当たり当期純利益 Net income per share (円/¥)



1 株当たり配当金 Dividends per share (円/¥)



## 2. セグメント別販売実績

セグメントの名称	当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	前年同期比(%)
半導体関連事業(千円)	3,075,110	107.8
不動産・建築関連事業(千円)	159,192	67.5
合計(千円)	3,234,302	104.7

(注)1. 前事業年度及び当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。

相手先	前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)		当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第一実業(株)	1,274,926	41.3	1,352,514	41.8
三菱電機(株)	363,072	11.8	506,188	15.7

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3. セグメント別受注状況

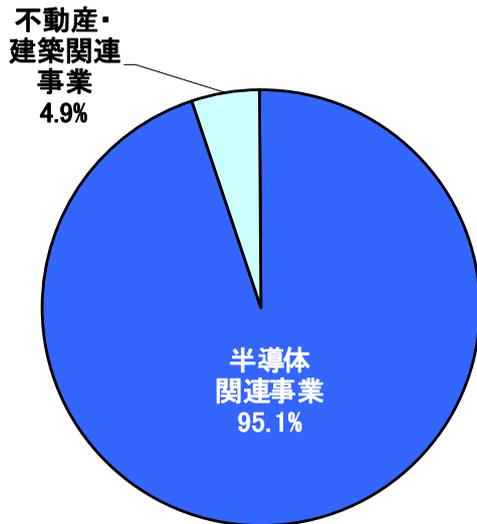
セグメントの名称	受注高 (千円)	前年同期比 (%)	受注残高 (千円)	前年同期比 (%)
半導体関連事業	2,801,558	84.5	1,106,310	80.2
不動産・建築関連事業	117,826	81.8	520	1.2
合計	2,919,384	84.4	1,106,831	77.9

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

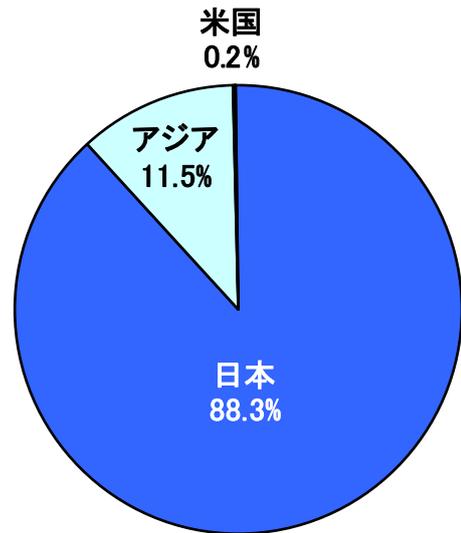


# 売上高及び受注高構成（27年3月期）

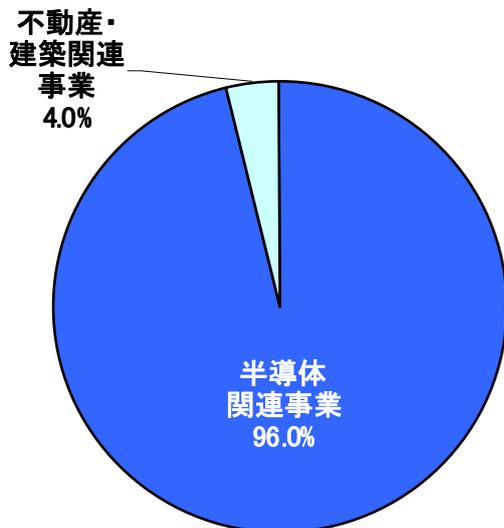
## セグメント別売上高



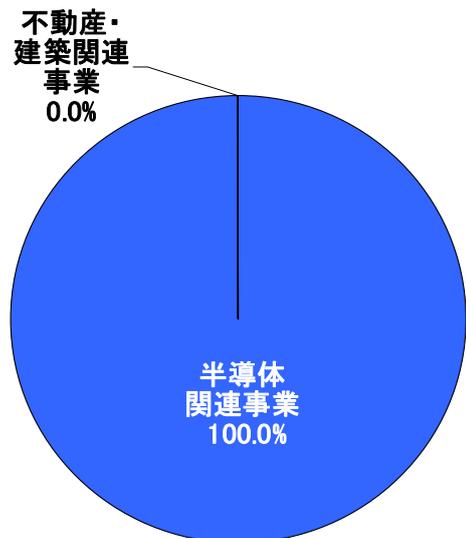
## 地域別売上高



## 受注高



## 受注高残高





## 2. 平成28年3月期通期業績予想

**第38期(平成28年3月期)の利益計画**
**a. 利益計画表**

項目	期別		第38期予想		増減
	第37期 (27年3月期)		(28年3月期)		
	千円	%	千円	%	千円
売上高	3,234,302	100.0	3,300,000	100.0	65,698
売上原価	3,245,829	100.4	2,820,000	85.5	△425,829
売上総利益又は 売上総損失(△)	△11,526	△0.4	480,000	14.5	491,526
販売管理費及び一般管理費	455,461	14.1	450,000	13.6	△5,461
営業利益又は営業損失(△)	△466,988	△14.4	30,000	0.9	496,988
営業外収益	34,572	1.1	15,000	0.5	△19,572
営業外費用	4,616	0.1	5,000	0.2	384
経常利益又は経常損失(△)	△437,032	△13.5	40,000	1.2	477,032
特別利益	35,302	1.1	170,000	5.2	134,698
特別損失	85,005	2.6	-	-	△85,005
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失(△)	△486,735	△15.0	210,000	6.4	696,735
法人税及び住民税	5,118	0.2	8,000	0.2	2,882
法人税等調整額	36,613	1.1	27,000	0.8	△9,613
当期純利益又は 当期純損失(△)	△528,467	△16.3	175,000	5.3	703,467

**b. 売上高のセグメント別内訳**

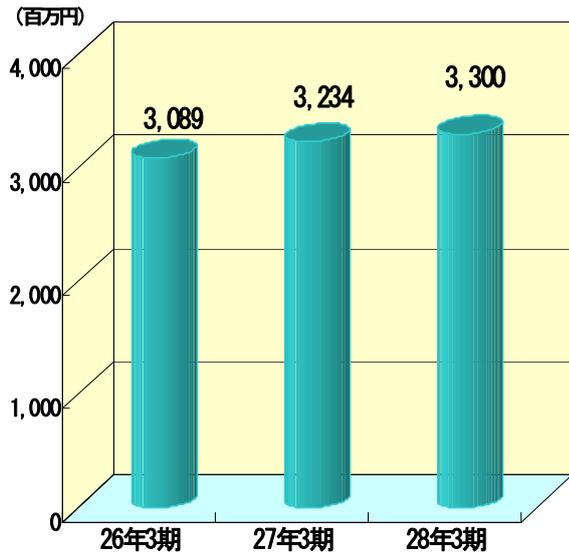
(単位:千円)

セグメントの名称	期別		第38期予想		増減
	第37期 (27年3月期)		(28年3月期)		
	千円	%	千円	%	千円
半導体関連事業	3,075,110	95.1	3,300,000	100.0	224,890
不動産・建築関連事業	159,192	4.9	-	-	△159,192
合計	3,234,302	100.0	3,300,000	100.0	65,698

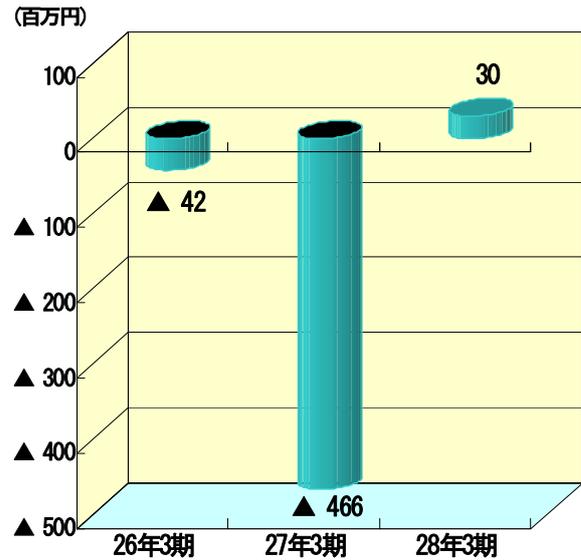
(注)本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

# 28年3月期の目標

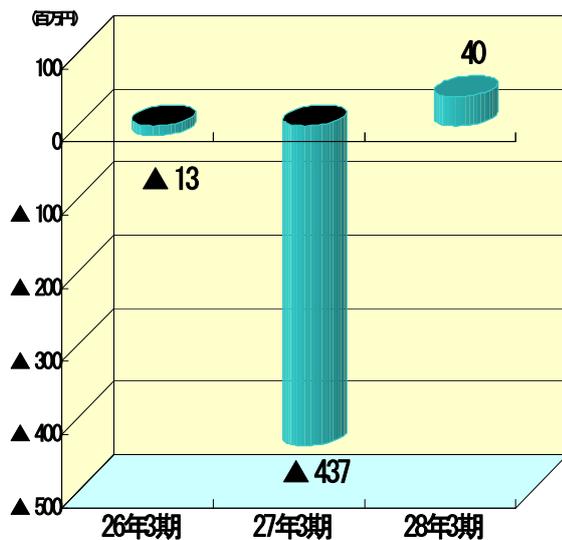
## 売上高



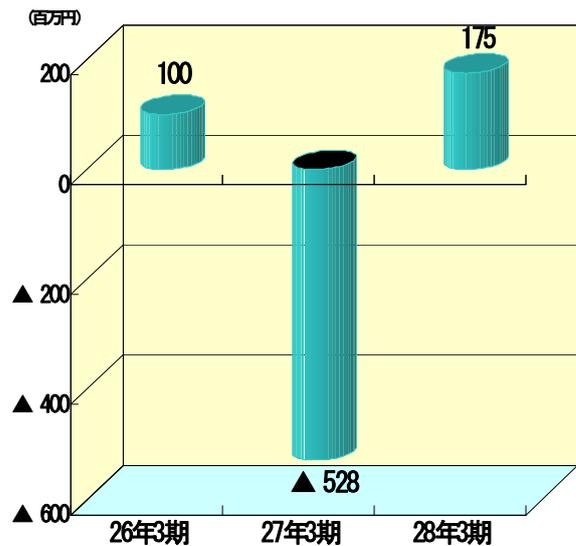
## 営業利益



## 経常利益



## 純利益





# 3. 会社概要

# 1. 当社の経営基本方針

当社は、「たゆまず前進する技術と創意工夫によって社会に貢献する」ことを経営理念としております。そして、「正しい見識を持って意欲的に即行動し新しい価値を生む」ことを行動理念とし、「ユーザーに深く感謝する精神で早く良いものを安くに徹する」ことを経営方針として業務に取り組んでおります。

当社は、半導体関連事業として半導体製造後工程装置やその精密金型の開発、設計、製造及び販売を行なっており、低騒音、省エネルギー、省スペース（小型化）をコンセプトとして切断・成形、マーキング、製品検査等を対象領域とする機器を提供しております。

## 2. 会社の概要

商 号 株式会社 石井工作研究所  
 (英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION. )  
 本 店 大分県大分市東大道二丁目5番60号  
 設立年月日 昭和54年(1979年)1月5日  
 事業内容

セクメントの 名 称	区 分	主 要 営 業 品 目
半 導 体 関 連 事 業	半 導 体 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	リード加工機 (BGA・CSP個片カット装置を含む) リード加工金型
	加 工 部 品	プラスチック成型加工品 プレス加工品 金属加工部品
	電 装 品	マイクロコンピューター 電装装置
	そ の 他	購入品 補修サービス
不 動 産 ・ 建 築 関 連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個人住宅・住宅用ホームエレベータ 太陽光発電装置

資 本 金 1,186,300,000 円 (平成27年3月31日現在)  
 株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株  
 発行済株式総数 7,800,000株 (平成27年3月31日現在)  
 1単元の株式数 100株

決 算 期 3月31日 (年1回)

役 員

代表取締役社長	石 井 仁 海
取締役	石 井 光 明
取締役	重 松 秀 信
取締役	時 枝 典 生
監査役 (常勤)	衛 藤 良 一
監査役	姫 野 昭 雄
監査役	伊 東 徳 (平成27年3月31日現在)

従 業 員 数 242名 (平成27年3月31日現在)  
 (従業員には、臨時従業員 (準社員) を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店  
 株式会社 三井住友銀行 大 分 支 店  
 三井住友信託銀行株式会社 大 分 支 店

**大 株 主**

(平成27年3月31日現在)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイイト株式会社	千株 2,550	% 32.80
石井工作研究所 従業員持株会	911	11.73
石 井 見 紀	453	5.83
松井証券株式会社	208	2.68
石 井 光 明	149	1.92
石 井 仁 海	139	1.79
株式会社大分銀行	124	1.60
日本証券金融株式会社	91	1.17
松 浦 兼 昭	61	0.78
石 井 貞 憲	60	0.78

(注) 持株比率は、自己株式(27,870株)を控除して計算しております。

### 3. 会社の沿革

年	月	概	要
昭和54年	1月	㈱石井工作研究所設立（資本金10,000千円）。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業開始。本社及び本社工場（旧大分工場）を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。	
昭和54年	6月	金属及び非金属材料販売を行うため丸善通商㈱設立。	
昭和55年	10月	数値制御による機械加工を集約するため㈱大分エヌシーセンター設立。	
昭和56年	4月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。	
昭和56年	5月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に㈱石井工研産業設立（後、株式会社へ組織変更）。	
昭和58年	12月	丸善通商㈱を㈱九栄システム（現北九州工場）に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。	
昭和59年	1月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。	
昭和60年	2月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。	
昭和61年	3月	半導体組立工程の5工程（①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類）を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD 300」を（財）大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。	
昭和61年	8月	半導体製造用の低騒音、超小型NCモータープレスの「ソフトプレス」開発。	
昭和61年	11月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン 86”に初めて出展。	
平成	3年10月	経営の合理化と経営効率を図るため、㈱大分エヌシーセンター、㈱九栄システム及び㈱石井工研産業を吸収合併。	
平成	4年 3月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」（協和（現りそな）中小企業振興財団・日刊工業新聞共催）を受賞。	
平成	4年 9月	「IC検査用画像処理装置」を開発。	
平成	5年 7月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト 93”に初めて出展。	
平成	5年 9月	本社ビル完成。	
平成	7年 4月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。	
平成	8年 8月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。	
平成	9年 2月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。	
平成	12年 8月	ISO14001 認証取得。	
平成	13年 6月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。	
平成	13年 8月	不動産事業を開始。	
平成	14年 1月	浄水事業を開始。	
平成	15年11月	大分曲工場第一期工事完成。	
平成	16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。	
平成	17年12月	大分曲工場第二期工事完成。	
平成	18年 2月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了	
平成	18年 7月	本店所在地を大分県大分市東大道二丁目5番60号に住所表示変更。	
平成	21年 4月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。	

年	月	概	要
平成21年	6月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。	
平成22年	4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQに上場。	
平成25年	4月	閉鎖していた北九州工場を売却。	
平成25年	7月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場。	
平成26年	5月	当社創業者 石井見敏氏逝去。	
平成27年	5月	大分羽田工場を売却。	

## 4. 営業所及び工場

① 本 社                    大分県大分市東大道二丁目5番60号

### ② 営業所

東京営業所                東京都港区

熊本営業所                熊本県熊本市

### ③ 工場

大分曲工場                大分県大分市

杵築工場                  大分県杵築市



# 4. 技術・新製品開発

## レーザーバリ取り装置

Laser Deflashing System

- ・レーザー光でパッケージ周辺の余分なレジンバリを除去します。
- ・モールドズレを画像認識で位置補正し、高精度加工します。
- ・金型では除去が厳しい微小加工が可能で、また、金型を使用しない為、消耗部品が不要です。



## 大型MAP基板 レーザーマーク装置

Laser Mark System for Large size MAP

- ・製品搬送ユニットに基板反り矯正機構を持たせ、反りの有る大型MAP基板のマークに最適です。
- ・マークされた製品は静電ブロー&ブラシクリーニングされマーク品質を画像認識で検査します。
- ・リードフレームのマークにも対応します。



## 小型ハンドプレス

Table Top Hand Press

- ・高剛性角ポストを使用したコンパクト低価格なハンドプレスです。
- ・手動加圧で高圧力加工でき、半導体パッケージの個片切断、薄板の打抜き、折り曲げ等の簡易プレス工程に最適です。



## 大型装置 (従来に比べて大型)

- ・半導体分野以外の液晶組立装置や、車載用部品組立装置も製作しています。



お問合せは、本社営業課、東京営業所、または [hsales@i-kk.co.jp](mailto:hsales@i-kk.co.jp) まで。

Contact us at Headquarter sales, Tokyo sales office, or [hsales@i-kk.co.jp](mailto:hsales@i-kk.co.jp) for any inquiry.

## ミニマルパッケージングコア装置（ミニマルシリーズ）

### 〈ミニマルダイボンダ〉

ミニマルサイズを実現した超コンパクトダイボンダ

- ・リアモータ制御によりボンディング機構の小型化と加圧制御の容易化を実現しました。



### 〈ミニマルインクジェットプリンター〉

ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜

- ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に収めました。
- ・ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜
- ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に収めました。
- ・ビットマップデータを変更するだけで描画パターンが変更できます。



本資料に関するお問い合わせ



**株式会社 石井工作研究所**  
**ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.**

**IR 担 当 者**

TEL : 097-544-1001

E-mail : [tokieda@i-kk.co.jp](mailto:tokieda@i-kk.co.jp)